

2017-2022年中国集成电路封装行业市场发展现状及十三五盈利战略分析报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2017-2022年中国集成电路封装行业市场发展现状及十三五盈利战略分析报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/277061277061.html>

报告价格：电子版: 7200元 纸介版：7200元 电子和纸介版: 7500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

封装技术的发展历程包含了很多种封装技术名称，但总体可以概括为从大到小（让封装面积和芯片面积趋近相同），从平面到立体，背后的实质是技术进步使得封装工艺能够适应终端产品的小型化和轻薄化。按照芯片与基板的连接方式，可以将集成电路封装技术的演进过程大致划分为几个阶段：通孔直插式封装技术（通过插孔安装到PCB板上）、表面贴装技术（通过细引线将芯片贴装到PCB板上）、面积阵列封装技术（焊球替代管脚和引线，比较典型的是当前广泛用于PC中CPU上的BGA封装）以及目前最前沿的3D封装技术。当前人们生活中所能接触到的产品主要采用面积阵列封装技术，但部分追求更高性能和更小体积的产品已经开始向3D封装技术迁移。

传统封装工艺流程

封装技术的演进，实质上是受终端需求的变化所引领。在智能手机兴起之前，集成电路产业主要受PC所拉动，当时PC上所有芯片之中最先进的就是中央处理器CPU和图形处理器GPU，因此最先进的封装技术都集中在这两个产品上，目标是不断适应芯片性能的快速提升，减少信息传输延迟，以及改善电热性能，因此我们看到当时BGA（一种通过大量锡球来连接芯片和基板的封装方式）封装渐渐成为主流。

随着芯片性能越来越高，传统的包括BGA在内的封装技术无法满足高性能芯片对输入输出引线（I/O）数量的要求，同时较长的引线也带来个较高的电阻和电磁干扰，在这样的背景下，覆晶封装（也称倒装）技术开始在CPU及GPU上逐渐普及。

与传统封装技术中，先将芯片至于封装基板上，再用打线技术（wirebonding）链接芯片的I/O触点与基板不同，覆晶封装技术（FC，Flip-Chip）首先借助锡、铅、金、铜等材料，在芯片的一面连接点长凸块（bumping），然后将芯片翻转过来使凸块与基板能够直接连接。这样做的好处是把芯片与基板的链接方式最短化，解决电磁干扰问题，并增强导电性，同时相比在芯片周边形成引线的方式，覆晶封装能够产生更小的封装面积，和更好的散热性能。覆晶封装技术是由IBM在上世纪60年代开发出来的。

在智能手机等移动终端普及的今天，由于其优良的导通能力和较小的封装尺寸，覆晶封装技术已经在移动终端上得以广泛应用，包括应用处理器（AP）、基带芯片（BB）、射频芯片（RF）和功率放大器等在内，目前都以覆晶封装为主要封装工艺。

2013年集成电路产业全行业销售收入2508亿元，同比增长16.19%。其中，芯片设计业近10年年均增长超过40%，成为拉动产业增长的主要动力。制造业加快追赶步伐，2013年销售收入同比增长接近20%。封装测试业稳步扩大，产业规模超过1000亿元。2014年中国集成电路市场规模超过1万亿元，增速高于全球市场。受多样化应用的驱动，市场规模仍将持续保持高速增长的态势，达到1.2万亿元，占全球集成电路市场半壁江山，同比增长将超过10%，远超全球3%的增速，继续成为引领全球集成电路市场增长的火车头。国际市场竞争加剧，国内政策、资金环境改善都将促使全球产业格局发生改变，在旺盛的市场需求带

动下，技术、资金的转移加速，我国集成电路产业迎来新的发展机遇。

2008-2014年我国集成电路固定资产投资增长情况

我国拥有全球最大、增长最快的集成电路市场，2013年规模达9166亿元，占全球市场份额的50%左右。随着我国经济发展方式的转变、产业结构的加快调整，工业化和信息化深度融合，大力推进信息消费，对集成电路的需求将大幅增长。预计2015年，国内产业销售收入将达到3300亿元，年平均增长率达到18%。我国极大规模集成电路制造工艺获突破，一批65-28纳米高端设备通过量产验证，而部分实现批量采购，40纳米成套工艺成功量产。我国已经在集成电路高端装备、成套工艺、关键材料、封装测试等领域取得了部分突破。除了上述制造工艺突破，光刻机整机集成及零部件技术水平也得到迅速提升，封测产业加速升级，专项成果辐射相关产业应用。旺盛的国内市场需求也是发展我国集成电路产业的强大动因。

2014年集成电路产业内销产值增长情况

中国报告网发布的《2017-2022年中国集成电路封装行业市场发展现状及十三五盈利战略分析报告》内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展动向、市场前景、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章：中国集成电路封装行业发展背景

1.1 集成电路封装行业定义及分类

1.1.1 集成电路封装行业定义

1.1.2 集成电路封装行业产品大类

1.1.3 集成电路封装行业特性分析

(1) 行业周期性

(2) 行业区域性

(3) 行业季节性

1.1.4 集成电路封装行业在集成电路产业中的地位分析

1.2 集成电路封装行业政策环境分析

1.2.1 行业管理体制

1.2.2行业相关政策

1.3集成电路封装行业经济环境分析

1.3.1国际宏观经济环境及影响分析

(1) 国际宏观经济现状

(2) 国际宏观经济环境对行业影响分析

1.3.2国内宏观经济环境及影响分析

(1) GDP增长情况分析

(2) 居民收入水平

1.4集成电路封装行业技术环境分析

1.4.1集成电路封装技术演进分析

1.4.2集成电路封装形式应用领域

1.4.3集成电路封装工艺流程分析

1.4.4集成电路封装行业新技术动态

第二章：中国集成电路产业发展分析

2.1集成电路产业发展状况

2.1.1集成电路产业链简介

2.1.2集成电路产业发展现状分析

(1) 行业发展势头良好

(2) 行业技术水平快速提升

(3) 行业竞争力仍有待加强

(4) 产业结构进一步优化

2.1.3集成电路产业区域发展格局分析

(1) 三大区域集聚发展格局业已形成

(2) 整体呈现“一轴一带”的分布特征

(3) 产业整体将“有聚有分，东进西移”

2.1.4集成电路产业面临的发展机遇

(1) 产业政策环境进一步向好

(2) 战略性新兴产业将加速发展

(3) 资本市场将为企业融资提供更多机会

2.1.5集成电路产业面临的主要问题

(1) 规模小

(2) 创新不足

(3) 价值链整合不够

(4) 产业链不完善

2.1.6集成电路产业“十三五”发展预测

2.2集成电路设计业发展状况

2.2.1集成电路设计业发展概况

2.2.2集成电路设计业发展特征

- (1) 产业规模持续扩大
- (2) 质量上升数量下降
- (3) 企业规模持续扩大
- (4) 技术能力大幅提升

2.2.3集成电路设计业发展隐忧

2.2.4集成电路设计业新发展策略

2.2.5集成电路设计业“十三五”发展预测

2.3集成电路制造业发展状况

2.3.1集成电路制造业发展现状分析

- (1) 集成电路制造业发展总体概况
- (2) 集成电路制造业发展主要特点
- (3) 集成电路制造业规模及财务指标分析

1) 集成电路制造业规模分析

2) 集成电路制造业盈利能力分析

3) 集成电路制造业运营能力分析

4) 集成电路制造业偿债能力分析

5) 集成电路制造业发展能力分析

2.3.2集成电路制造业经济指标分析

- (1) 集成电路制造业主要经济效益影响因素
- (2) 集成电路制造业经济指标分析
- (3) 不同规模企业主要经济指标比重变化情况分析
- (4) 不同性质企业主要经济指标比重变化情况分析
- (5) 不同地区企业经济指标分析

2.3.3集成电路制造业供需平衡分析

(1) 全国集成电路制造业供给情况分析

1) 全国集成电路制造业总产值分析

2) 全国集成电路制造业产成品分析

(2) 全国集成电路制造业需求情况分析

1) 全国集成电路制造业销售产值分析

2) 全国集成电路制造业销售收入分析

(3) 全国集成电路制造业产销率分析

2.3.4集成电路制造业“十三五”发展预测

第三章：中国集成电路封装行业发展分析

3.1中国集成电路封装行业整体发展情况

3.1.1集成电路封装行业规模分析

3.1.2集成电路封装行业发展现状分析

3.1.3集成电路封装行业利润水平分析

3.1.4大陆厂商与业内领先厂商的技术比较

3.1.5集成电路封装行业影响因素分析

(1) 有利因素

(2) 不利因素

3.1.6集成电路封装行业发展趋势及前景预测

(1) 发展趋势分析

(2) 前景预测

3.2半导体封测发展情况分析

3.2.1半导体行业发展概况

3.2.2半导体行业景气预测

3.2.3半导体封装发展分析

(1) 封装环节产值逐年成长

(2) 封装环节外包是未来发展趋势

3.3集成电路封装类专利分析

3.3.1专利分析样本构成

(1) 数据库选择

(2) 检索方式

3.3.2专利发展情况分析

(1) 专利申请数量趋势

(2) 专利公开数量趋势

(3) 技术类型情况分析

(4) 技术分类趋势分布

(5) 主要权利人分布情况

3.4集成电路封装过程部分技术问题探讨

3.4.1集成电路封装开裂产生原因分析及对策

(1) 封装开裂的影响因素分析

(2) 管控影响开裂的因素的方法分析

3.4.2集成电路封装芯片弹坑问题产生原因分析及对策

(1) 产生芯片弹坑问题的因素分析

(2) 预防芯片弹坑问题产生的方法

第四章：中国集成电路封装行业市场需求分析

4.1 集成电路市场分析

4.1.1 集成电路市场规模

4.1.2 集成电路市场结构分析

(1) 集成电路市场产品结构分析

(2) 集成电路市场应用结构分析

4.1.3 集成电路市场竞争格局

4.1.4 集成电路国内市场自给率

4.1.5 集成电路市场发展预测

4.2 集成电路封装行业主要产品分析

4.2.1 BGA产品市场分析

(1) BGA封装技术

(2) BGA产品主要应用领域

(3) BGA产品需求拉动因素

(4) BGA产品市场应用现状分析

(5) BGA产品市场前景展望

4.2.2 SIP产品市场分析

(1) SIP封装技术

(2) SIP产品主要应用领域

(3) SIP产品需求拉动因素

(4) SIP产品市场应用现状分析

(5) SIP产品市场前景展望

4.2.3 SOP产品市场分析

(1) SOP封装技术

(2) SOP产品主要应用领域

(3) SOP产品市场发展现状

(4) SOP产品市场前景展望

4.2.4 QFP产品市场分析

(1) QFP封装技术

(2) QFP产品主要应用领域

(3) QFP产品市场发展现状

(4) QFP产品市场前景展望

4.2.5 QFN产品市场分析

(1) QFN封装技术

(2) QFN产品主要应用领域

- (3) QFN产品市场发展现状
- (4) QFN产品市场前景展望
- 4.2.6 MCM产品市场分析
 - (1) MCM封装技术水平概况
 - 1) 概念简介
 - 2) MCM封装分类
 - (2) MCM产品主要应用领域
 - (3) MCM产品需求拉动因素
 - (4) MCM产品市场发展现状
 - (5) MCM产品市场前景展望
- 4.2.7 CSP产品市场分析
 - (1) CSP封装技术水平概况
 - 1) 概念简介
 - 2) CSP产品特点
 - 3) CSP封装分类
 - (2) CSP产品主要应用领域
 - (3) CSP产品市场发展现状
 - (4) CSP产品市场前景展望
- 4.2.8 其他产品市场分析
 - (1) 晶圆级封装市场分析
 - 1) 概念简介
 - 2) 产品特点
 - 3) 主要应用领域
 - 4) 市场规模与主要供应商
 - 5) 前景展望
 - (2) 覆晶/倒封装市场分析
 - 1) 概念简介
 - 2) 产品特点
 - 3) 市场前景
 - (3) 3D封装市场分析
 - 1) 概念简介
 - 2) 封装方法
 - 3) 封装特点
 - 4) 发展现状与前景
- 4.3 集成电路封装行业市场需求分析

4.3.1 计算机领域对行业的需求分析

- (1) 计算机市场发展现状
- (2) 集成电路在计算机领域的应用
- (3) 计算机领域对行业需求的拉动

4.3.2 消费电子领域对行业的需求分析

- (1) 消费电子市场发展现状
- (2) 消费电子领域对行业需求的拉动

4.3.3 通信设备领域对行业的需求分析

- (1) 通信设备市场发展现状
- (2) 集成电路在通信设备领域的应用
- (3) 通信设备领域对行业需求的拉动

4.3.4 工控设备领域对行业的需求分析

- (1) 工控设备市场发展现状
- (2) 集成电路在工控设备领域的应用
- (3) 工控设备领域对行业需求的拉动

4.3.5 汽车电子领域对行业的需求分析

- (1) 汽车电子市场发展现状
- (2) 集成电路在汽车电子领域的应用
- (3) 汽车电子领域对行业需求的拉动

4.3.6 其他应用领域对行业的需求分析

第五章：集成电路封装行业市场竞争分析

5.1 集成电路封装行业国际竞争格局分析

5.1.1 国际集成电路封装市场总体发展状况

5.1.2 国际集成电路封装市场竞争状况分析

5.1.3 国际集成电路封装市场发展趋势分析

- (1) 封装技术的高密度、高速和高频率以及低成本
- (2) 主板材料的变化趋势

5.1.4 跨国企业在华市场竞争力分析

- (1) 台湾日月光集团竞争力分析

1) 企业发展简介

2) 企业经营情况分析

3) 企业主营产品及应用领域

4) 企业市场区域及行业地位分析

5) 企业在中国市场投资布局情况

- (2) 美国安靠 (Amkor) 公司竞争力分析

- 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
- (3) 台湾矽品公司竞争力分析
- 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
- (4) 新加坡STATS-ChipPAC公司竞争力分析
- 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
- (5) 力成科技股份有限公司竞争力分析
- 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
- (6) 飞思卡尔公司竞争力分析
- 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况
- (7) 英飞凌科技公司竞争力分析
- 1) 企业发展简介
 - 2) 企业经营情况分析
 - 3) 企业主营产品及应用领域
 - 4) 企业市场区域及行业地位分析
 - 5) 企业在中国市场投资布局情况

5.2 集成电路封装行业国内竞争格局分析

5.2.1 国内集成电路封装行业竞争格局分析

5.2.2 中国集成电路封装行业国际竞争力分析

5.3 集成电路封装行业竞争结构波特五力模型分析

5.3.1 现有竞争者之间的竞争

5.3.2 上游议价能力分析

5.3.3 下游议价能力分析

5.3.4 行业潜在进入者分析

5.3.5 替代品风险分析

5.3.6 行业竞争五力模型总结

第六章：中国集成电路封装行业主要企业经营分析

6.1 集成电路封装企业发展总体状况分析

6.1.1 集成电路封装行业制造商销售收入排名

6.1.2 集成电路封装行业制造商利润总额排名

6.2 集成电路封装行业领先企业个案分析

6.2.1 飞思卡尔半导体（中国）有限公司经营情况分析

（1）企业概况

（2）主营产品概况

（3）公司运营情况

（4）公司优劣势分析

6.2.2 威讯联合半导体（北京）有限公司经营情况分析

（1）企业概况

（2）主营产品概况

（3）公司运营情况

（4）公司优劣势分析

6.2.3 江苏长电科技股份有限公司经营情况分析

（1）企业概况

（2）主营产品概况

（3）公司运营情况

（4）公司优劣势分析

6.2.4 上海松下半导体有限公司经营情况分析

（1）企业概况

（2）主营产品概况

（3）公司运营情况

（4）公司优劣势分析

6.2.5深圳赛意法微电子有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.6南通富士通微电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.7三星电子（苏州）半导体有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.8日月光封装测试（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.9瑞萨半导体（北京）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.10英飞凌科技（无锡）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.11星科金朋（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.12 硕中科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.13 天水华天科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.14 安靠封装测试（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.15 矽品科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.16 晟碟半导体（上海）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.17 新义半导体（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.18 华润微电子有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.19苏州晶方半导体科技股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.20智瑞达科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.21大唐微电子技术有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.22吴江巨丰电子有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.23上海纪元微科电子有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.24苏州固锝电子股份有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.25凤凰半导体通信（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.26京隆科技（苏州）有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

6.2.27苏州日月新半导体有限公司经营情况分析

- (1) 企业概况
- (2) 主营产品概况
- (3) 公司运营情况
- (4) 公司优劣势分析

第七章：中国集成电路封装行业投资分析及建议

7.1集成电路封装行业投资特性分析

7.1.1集成电路封装行业进入壁垒

- (1) 技术壁垒
- (2) 资金壁垒
- (3) 人才壁垒
- (4) 严格的客户认证制度

7.1.2集成电路封装行业盈利模式

7.1.3集成电路封装行业盈利因素

7.2集成电路封装行业投资兼并与重组分析

7.2.1集成电路封装行业投资兼并与重组整合概况

7.2.2国际集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

7.2.3国内集成电路封装企业投资兼并与重组整合分析

- (1) 通富微电公司投资兼并与重组分析
- (2) 华天科技公司投资兼并与重组分析
- (3) 长电科技公司投资兼并与重组分析

7.2.4集成电路封装行业投资兼并与重组整合趋势分析

7.3集成电路封装行业投融资分析

7.3.1电子发展基金对集成电路产业的扶持分析

- (1) 电子发展基金对集成电路产业的扶持情况
- (2) 电子发展基金对集成电路产业的扶持建议

7.3.2集成电路封装行业融资成本分析

7.3.3半导体行业资本支出分析

7.4集成电路封装行业投资建议

7.4.1集成电路封装行业投资机会分析

7.4.2集成电路封装行业投资风险分析

7.4.3集成电路封装行业投资建议

(1) 投资区域建议

(2) 投资产品建议

(3) 技术升级建议

图表目录

图表：集成电路封装行业产品分类

图表：我国集成电路封装企业地区分布（单位：%）

图表：2016年江苏长电科技股份有限公司销售收入季度分布（单位：万元）

图表：2009-2016年以来集成电路封装在集成电路产业中占比变化（单位：%）

图表：集成电路封装行业主要政策分析

图表：2016年发达经济体增长情况（单位：%）

图表：2016年主要新兴经济体增长情况（单位：%）

图表：2016年主要国家经济增长速度（单位：%）

图表：2016年世界银行和IMF对于世界主要经济体的预测（单位：%）

图表：2009-2016年中国国内生产总值及其增长速度（单位：亿元，%）

图表：2009-2016年以来中国GDP增速与集成电路封装行业产值增速对比图（单位：%）

图表：2009-2016年我国城镇居民人均可支配收入及其变化趋势（单位：元，%）

图表：2009-2016年我国农村居民纯收入及其变化趋势（单位：元，%）

图表：封装技术的演进

图表：各种集成电路封装形式应用领域

图表：集成电路封装工艺流程

图表：集成电路产业链示意图

图表：2016年中国集成电路产业发展情况（单位：亿元，亿块，亿美元，%）

图表：2016年我国集成电路产业结构（单位：%）

图表：中国集成电路产业长三角地区分布概况

图表：未来集成电路产业的整体空间布局特点分析

图表：2009-2016年我国集成电路设计市场销售额走势（单位：亿元）

图表：集成电路设计业新发展策略

图表：集成电路制造业发展主要特点分析

图表：2011-2016年中国集成电路制造业规模分析（单位：家，人，万元）

图表：2011-2016年中国集成电路制造业盈利能力分析（单位：%）

图表：2011-2016年中国集成电路制造业运营能力分析（单位：次）

图表：2011-2016年中国集成电路制造业偿债能力分析（单位：% ，倍）

图表：2011-2016年中国集成电路制造业发展能力分析（单位：%）

图表：2011-2016年中国集成电路制造业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家，%）

图表：2014-2016年不同规模企业数量比重变化趋势图（单位：%）

图表：2014-2016年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

图表：2014-2016年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

（GYZX）

图表详见正文

特别说明：中国报告网所发行报告书中的信息和数据部分会随时间变化补充更新，报告发行年份对报告质量不会有任何影响，请放心查阅。

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/jichengdianlu/277061277061.html>